

**Fusion Technology**

To the future of the 3D printer

L-DEVO® 3DPrinter  
総合カタログ 2021-2022



L-DEVO®  
F300TP PLUS

## PLA

◇大型造形物におすすめ

◇熱に弱い、耐候性が弱い

印刷時の歪みが少なく大型造形物におすすめ。熱に弱く耐候性が弱いためモックアップ向き

## Poly Lite PLA

コストに優れ、ノズル詰まりしにくい。細かい形状のモデルに最適

1000g カラー:ホワイト・ブラック・ブルーグリーン(Teal)・レッド・オレンジ  
ブルー・イエロー・グリーン・グレー・パープル

3000g カラー:ホワイト・ブラック

## PolyMax PLA

耐衝撃性に優れた強化PLA

750g カラー:ホワイト・ブラック・ブルーグリーン(Teal)・レッド  
オレンジ・ブルー・イエロー・グリーン・グレー・パープル

3000g カラー:ホワイト・ブラック・グレー

## ABS

◇そこそこの強度・耐熱性あり

◇反り易く大型造形に不向き

一般的なエンブラ。そこそこの強度・耐熱性がある。しかし反り・割れやすく大型造形は難しい。10cm角以内のモデルで強度・耐熱性(90°前後)が必要な場合に

## Poly Lite ABS

コストに優れ、ノズル詰まりしにくいABS素材。

1000g カラー:ホワイト・ブラック・ブルーグリーン(Teal)・レッド  
オレンジ・ブルー・イエロー・グリーン・グレー・パープル

3000g カラー:ホワイト

## L-DEVO スペック一覧

V5 ノズル対応

BuildTAK初期備品

F2030TP PLUS



F300TP PLUS



M4040TP V5



※実際の印刷では、設定により各軸-10mm程小さくなります。

最大プリントエリア	W200×D200×H300mm	W310×D310×H450mm	W400×D400×H400mm
積層ピッチ	0.05~0.30mm	0.05~0.30mm	0.05~0.30mm
使用可能マテリアル	PolyMax(PLA) / PolySmooth(PLA) / PolyMide CoPA(ナイロン) / PolyMax PC / PolyFlex TPU95-HF PolyLite(PLA/ABS/PC)	PolyMax(PLA) / PolySmooth(PLA)	PolyMide CoPA(ナイロン) / PolyFlex TPU95-HF / PolyLite(PLA)
ホットテーブル	あり(120℃)	あり(120℃)	あり(90℃)
ノズル数	1ノズル	1ノズル	1ノズル
最高ノズル温度	300℃	300℃	300℃
タッチパネルサイズ	3.8インチ	7インチ	3.8インチ
データ転送方法	USBケーブル(プリント開始後、取り外し可能) / USBメモリ	USBケーブル(プリント開始後、取り外し可能) / USBメモリ	USBケーブル(プリント開始後、取り外し可能) / USBメモリ
付属スライスソフト	L-DEVO Cura 4.8.2 64bit (Windows10 以上推奨)	L-DEVO Cura 4.8.2 64bit (Windows10 以上推奨)	L-DEVO Cura 4.8.2 64bit (Windows10 以上推奨)
入力形式	STL	STL	STL
スライスソフト使用環境	第5世代インテル Core iシリーズ プロセッサ以上/メモリ8GB以上/解像度1024*768以上		
本体重量	約22kg	約55kg	約40kg
本体サイズ	W360×D360(シャフト装着時500)×H540mm	W504×D504(シャフト装着時674)×H1004mm	W570×D570(シャフト装着時720)×H750mm
カートンサイズ	約W450×D510×H600mm	約W620×D610×H1050mm	約W730×D670×H820mm
ノズル孔径	0.4mm径 (オプションで0.2/0.8径もあり)	0.4mm径 (オプションで0.2/0.8径もあり)	0.4mm径 (オプションで0.2/0.8径もあり)
使用フィラメント径	1.75mm	1.75mm	1.75mm
最大プリント速度	80mm/s	80mm/s	80mm/s
推奨プリント速度	40mm/s 以下	40mm/s 以下	40mm/s 以下
電源	ACアダプター100-240V,50/60Hz	AC100V	AC100V
消費電力	280W	600W	600W
その他仕様	BuildTAK標準装備 トップカバー標準装備	BuildTAK標準装備 安全カバー標準装備	印刷バックアップ機能
	印刷バックアップ機能	フルカバー標準装備(開閉可) フィラメント切れ自動停止機能 非常停止ボタン装備	アクリルカバー標準装備 フィラメント切れ自動停止機能
	フィラメント切れ自動停止機能	フロント・トップドア鍵付き セミオートキャリブレーション機能	BuildTAK標準装備
		正面ドアセンサー内蔵(印刷中開放で自動停止)	
		庫内LED照明標準装備	

2021.7

## 販売・企画

株式会社フュージョンテクノロジー  
〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3  
REID-C Higashi Ikebukuro-bldg 6F  
TEL:03-6914-1634 FAX:03-5391-9656  
mail: info@fusiontechnology.co.jp  
HP: https://fusiontechnology.co.jp/



販売代理店

## L-DEVO F2030TP PLUS / F300TP PLUS 用パーツ

 <p><b>ノズルパーツ V5 0.2 /0.4 /0.8</b></p> <p>より安定した造形を行える改良型ノズルパーツ。メンテナンス性も向上。デフォルトは0.4mm径になりますが、用途に合わせて0.2mm、0.8mmと変更可能になりました。</p> <p>※ ノズル径にあわせて設定が必要です。ご注意ください。</p> <p>消耗品 / 交換目安: 本体1年 ノズル4か月</p>	 <p><b>BuildTAK 22cm角/34cm角/42cm角</b></p> <p>造形定着補助シートとして幅広い樹脂に対応。Fシリーズには初期備品として標準装備されています。サイズはプリンターのサイズで使い分けしてください。</p> <p>※22cm角は4枚1セット</p> <p>消耗品 / 交換目安: 3か月</p>	 <p><b>エクストルーダーモーター</b></p> <p>押し出しヘッド部分に使用します。耐久性が高まった新型ギア付き。交換はモータごとになります。</p> <p>消耗品 / 交換目安: 1年</p>
 <p><b>ノズルユニットV5 0.2 /0.4 /0.8</b></p> <p>消耗品である「交換ノズル」をユニット化しました。通常ノズル穴径は0.4mmですがオプションで「さらに細かい造形用」の0.2mm、「造形時間が飛躍的に早くなる」0.8mmもご用意。V3/ノズルとの互換性はありません。</p> <p>※ ノズル径にあわせて設定が必要です。ご注意ください。</p> <p>消耗品 / 交換目安: 4か月</p>	 <p><b>ファンパーツ</b> (F300TP/F2030TP PLUS用は別)</p> <p>V5ノズル専用。ノズルファンV3+サイドファンV1+キャリブレーションセンサー(F2030TP用は無し)+ベースのセット。</p> <p>消耗品 / 交換目安: 1年</p>	 <p><b>エクストルーダーギアボックス+ペアリング</b></p> <p>押し出しヘッド部分に使用します。</p> <p>消耗品 / 交換目安: 3か月</p>
 <p><b>F300TP PLUS 専用ガラスボード</b></p> <p>F300TP PLUS専用のガラスボードになります。初期備品にはBuildTAKが貼ってありますが、ボード交換時はBuildTAKを貼りなおしてください。</p>	 <p><b>セルボード</b></p> <p>F2030TP PLUSでは造形プレートがセルボードになります。BuildTAKを貼って造形を行ってください。</p>	 <p><b>ガラスボード 4040用</b></p> <p>M4040TP V5用のガラスボードになります。BuildTAKを貼って使用してください。</p>
 <p><b>エクストルーダーファン+スチールカバー</b></p> <p>F2030TP PLUS、M4040TP V5用エクストルーダーヘッド部のスチールカバー+ファン+基盤のセット</p>	 <p><b>TPU95-HF専用エクストルーダーヘッド</b></p> <p>TPUフィラメントは柔らかく、通常のエクストルーダーヘッドではうまく押し出せません。「TPU95-HF専用エクストルーダーヘッド」は柔らかいフィラメントをうまく押し出せるギアがある為、TPUフィラメントを使用する場合は必須になります。</p> <p>※ 専用の設定が必要です。ご注意ください。</p>	

## L-DEVO フィラメント

### PC ◇強度・耐熱性に優れる ◇反り易く大型造形に不向き ◇ゴムのような柔らかさ ◇専用ギアが必要

透明性があり寸法安定性に優れた汎用エンブレ。強度・耐熱性にも優れるが、反り・割れやすく大型造形は難しい。10cm角以内のモデルで強度・耐熱性(120°前後)が必要な場合に

#### PolyMax PC

通常のPCより強度を向上させた強化PC  
750g カラー: ホワイト・ブラック  
3000g カラー: ホワイト・ブラック

#### PolyLite PC

透明性があるベーシックなPC素材  
1000g カラー: クリア

### PA (ナイロン) ◇強度・耐熱性に優れる ◇吸湿性が大きい

強度に優れ、高い耐熱性もある。ただ吸湿性が高く、印刷時は「PolyBOX」等の除湿BOXでの使用が必須。強度・耐熱性(140°前後)が必要な場合に

#### PolyMide CoPA

PA6と66の間の物性値を持つ。PolyBoxと専用ノズルが必要。他のフィラメントと併用不可  
750g カラー: ブラック

#### PolyMide PA 6-CF

高強度、耐衝撃性、および熱変形温度(荷重たわみ温度)を有する炭素繊維混合強化ナイロンフィラメント。PolyBoxと専用ノズルが必要。他のフィラメントと併用不可  
500g/2000g カラー: ブラック

#### PolyMide PA 6-GF

CFの次に高い耐衝撃性、剛性を有するガラス繊維混合強化ナイロンフィラメント。PolyBoxと専用ノズルが必要。他のフィラメントと併用不可  
500g/2000g カラー: グレー

### TPU95-HF ◇ゴムのような柔らかさ ◇専用ギアが必要

ゴムのような弾性と樹脂の強度を併せ持つ、TPUが原料。柔らかい素材の為、専用ギアが必須。

#### Poly Flex TPU95-HF

流動性が高く100mm/s以上の高速印刷が可能ハイフローTPU95フィラメント  
750g カラー: ホワイト・ブラック

### Other

#### PolySmooth

IPA、エタノール等で溶けるフィラメント  
「PolySher」(別売)が必須  
750g カラー: ホワイト・ブラック・レッド・ブルー・グリーン・イエロー・グレー  
オレンジ・ピンク・ベージュ・ブルーグリーン(Teal)・クリア

※画像のPolySherは別売です。



L-DEVO

PLA

PA(NYL)

TPU95-HF

PA-CF/GF

PETG

etc.

# M4040TP V5

シリーズ最大プリントエリアを持つ  
大型モデル。PLA 専用機



初期備品にアクリルカバー追加されました

- 最大プリントエリア W400×D400×H400mm
- 積層ピッチ ※1 0.05 ~ 0.30mm
- ノズル温度 最高 300°C
- 使用可能マテリアル PolyLite PLA / PolyMax PLA / PolyFlex TPU95-HF / PolyMide CoPA  
Polymide PA6-CF / Polymide PA6-GF / PolyLite PETG

※1 0.05mmは条件付きの設定です。全てのデータを保証するものではありません。  
 ※2 TPUを使用する場合は別売の「TPU95-HF専用エクストルーダヘッド」が必要になります。  
 ※3 PolyMide CoPAを使用する場合は別売の「PolyBOX」「専用ノズル」が必要になります。  
 ※4 Polymide PA6-CF / GFを使用する場合は別売の「PolyBOX」「専用ノズル」が必要です。



使用フィラメント径 1.75mm

ノズル穴径 0.4mm (オプションで 0.2 / 0.8 穴径もあり)

最大プリント速度 80mm/s (推奨プリント速度 40mm/s 以下)

ホットテーブル あり (MAX 90°C)

ヘッド (ノズル) 数 1 個

データ転送方法 USB ケーブル (プリント開始後取り外し可能) / USB メモリ

付属スライスソフト L-DEVO Cura4.8.2 64bit (Windows 10 以上)

入力型式 STL

環境 第5世代インテルCore i シリーズプロセッサ以上 / メモリ 8GB 以上 / 解像度 1024\*768 以上

本体重量 約 40Kg

本体サイズ W570×D570×H750mm (シャフト装着時 奥行約 720mm)

電源 AC100V

消費電力 600W

初期備品 PLA フィラメント (1,000g) × 1巻, ガラスボード, BuildTAK42×42, アクリルカバー  
交換ノズル (0.4) × 1本, ニッパー・スクレイパー・レンチなど工具一式



## 「BuildTAK」が初期備品に

これまでオプションだった定着シートの「BuildTAK」が初期備品に加わり造形が安定して行えるようになりました。

## フィラメント切れセンサー搭載



印刷時によくある「材料切れ」による失敗を軽減。安定した印刷が可能になりました。

## 「V5」ノズル搭載

「ノズルが詰まりにくい」新型の「V5ノズル」を標準装備。これまでエラー原因として多かった「ノズル詰まり」を大幅に改善しました。またノズル温度はこれまでの 250°Cから「300°C」に上昇。これまでのエンブラはもちろん、高温域のフィラメントまで使用が可能になりました。



## 新型ホットベッド

これまでのホットベッドヒーターをビルドプレート全面に広げ、ホットベッドの温度ムラを極力抑えました。



## 初期備品に「アクリルカバー」が追加されました

これまでオプションだった側面の「アクリルカバー」も初期備品に加われました。





# L-DEVO

# F300TP PLUS

- PLA
- ABS
- PC
- ASA
- PA(NYL)
- PA-CF/GF
- TPU95-HF
- PETG
- etc.

機能・安全面でもさらに洗練させた  
L-DEVO シリーズ フラグシップモデル

- 最大プリントエリア W310×D310×H450mm
- 積層ピッチ <sup>※1</sup> 0.05 ~ 0.30mm ※2 実際の印刷では、設定により各軸-10mm程小さくなります。
- ノズル温度 **最高 300°C**
- 使用可能マテリアル PolyLite PLA / PolyLite ABS / PolyMax PLA / PolyFlex TPU95-HF <sup>※2</sup>  
PolyMax PC / PolyLite PC / PolyMide CoPA / PolySmooth <sup>※3</sup>  
Polyimide PA6-CF / Polyimide PA6-GF / PolyLite PETG <sup>※4</sup>

<sup>※1</sup> 0.05mm は条件付きの設定です。全てのデータを保証するものではありません。  
<sup>※2</sup> TPU を使用する場合は別売の「TPU95-HF 専用エクストルーダヘッド」が必要になります。  
<sup>※3</sup> PolyMide CoPA を使用する場合は別売の「PolyBOX」「専用ノズル」が必要になります。  
<sup>※4</sup> Polyimide PA6-CF / GF を使用する場合は別売の「PolyBOX」「専用ノズル」が必要です。



初期備品にPLA用安全カバー追加されました



使用フィラメント径	1.75mm
ノズル穴径	0.4mm (オプションで0.2 / 0.8 穴径もあり)
最大プリント速度	80mm/s (推奨プリント速度 40mm/s 以下)
ホットテーブル	あり (MAX 120°C)
ヘッド (ノズル) 数	1 個
データ転送方法	USB ケーブル (プリント開始後取り外し可能) / USB メモリ
付属スライスソフト	L-DEVO Cura4.8.2 64bit (Windows 10 以上)
入力型式	STL
環境	第5世代インテルCore i シリーズプロセッサ以上 / メモリ 8GB 以上 / 解像度 1024*768 以上
本体重量	55Kg
本体サイズ	W504×D504×H1004mm (シャフト展開時 奥行 674mm)
電源	AC100V
消費電力	600W
初期備品	PLA フィラメント (1,000g) × 1 巻, BuildTAK 34×34 (ガラスプレートに添付済み) PLA 用安全カバー, 交換ノズル (0.4) × 1 本, ニッパー・スクレイパー・レンチなど工具一式

## セミオートキャリブレーション 搭載

面倒だった造形テーブルのレベル調整が「セミオート」になりました。ノズル部分に搭載した光学センサーによって距離を測定、見やすい大型「アインチャッチパネル」で調整方法を解り易くナビゲート。具体的に画面表示して調整方法を案内するため、これまで以上に「誰にでも簡単に」調整が可能です。



## フルカバー仕様 BuildTAK 標準装備

これまでオプションだった「ABS 用保温カバー」が一体化。より保温力も高まりました。また定着シートの「BuildTAK」も初期備品に加わり造形が安定して行えるようになりました。

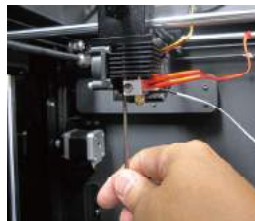
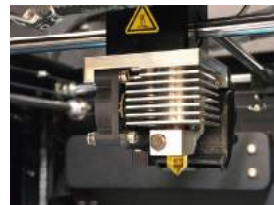


## 新型ホットベッド

これまでのホットベッドヒーターをビルドプレート全面に広げ、ホットベッドの温度ムラを極力抑えました。

## 「V5」ノズル搭載

「ノズルが詰まりにくい」新型の「V5 ノズル」を標準装備。これまでエラー原因として多かった「ノズル詰まり」を大幅に改善しました。またノズル温度はこれまでの 250°C から「300°C」に上昇。これまでのエンブラはもちろん、高温域のフィラメントまで使用が可能になりました。



## 各種安全装備も充実

現場からのご要望が多かった「非常停止ボタン」を実装。フロント・トップドアも施錠可能に。



# L-DEVO

# F2030TP PLUS

PLA

ABS

PC

TPU95-HF

ASA

PA(NYL)

PA-CF/GF

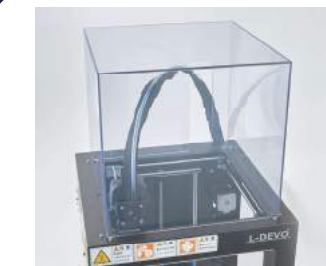
PETG

etc.

フィラメント切れセンサー搭載  
より使いやすくなった小型モデルの決定版

- 最大プリントエリア W200×D200×H300mm
- 積層ピッチ ※1 ※実際の印刷では、設定により各軸-10mm程小さくなります。  
0.05 ~ 0.30mm
- ノズル温度 最高 300°C
- 使用可能マテリアル PolyLite PLA / PolyLite ABS / PolyMax PLA / PolyFlex TPU95-HF ※2  
PolyLite ASA / PolyMax PC / PolyLite PC / PolyMide CoPA ※3  
Polymide PA6-CF / Polymide PA6-GF / PolyLite PETG / PolySmooth ※4

※1 0.05mmは条件付きの設定です。全てのデータを保証するものではありません。  
※2 ABS・PCを造形する場合、初期備品の「トップカバー」が必要になります。  
※3 TPUを使用する場合は別売の「TPU95-HF 専用エクストルーダヘッド」が必要になります。  
※4 使用する場合は別売の「PolyBOX」が必要になります。  
※5 Polymide PA6-CF / GFを使用する場合は別売の「PolyBOX」「専用ノズル」が必要です。



初期備品にトップカバーが追加されました



使用フィラメント径 1.75mm

ノズル穴径 0.4mm (オプションで 0.2 / 0.8 穴径もあり)

最大プリント速度 80mm/s (推奨プリント速度 40mm/s 以下)

ホットテーブル あり (MAX 120°C)

ヘッド (ノズル) 数 1 個

データ転送方法 USB ケーブル (プリント開始後取り外し可能) / USB メモリ

付属スライスソフト L-DEVO Cura4.8.2 64bit (Windows 10 以上)

入力型式 STL

環境 第5世代インテル Core i シリーズプロセッサ以上 / メモリ 8GB 以上 / 解像度 1024\*768 以上

本体重量 22Kg

本体サイズ W360×D360×H540mm (シャフト装着時 奥行約 500mm)

電源 AC アダプター 100-240V, 50/60Hz

消費電力 280W

初期備品 PLA フィラメント (1,000g) × 1 巻, セルボード, BuildTAK, トップカバー  
交換ノズル (0.4) × 1 本, ニッパー・スクレイパー・レンチなど工具一式

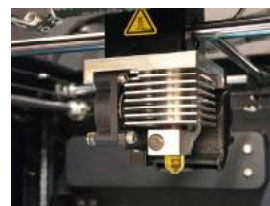
## 100-240V AC アダプター

外部電源にしたことで本体の軽量化と共に、安全性を高めました。



## 「V5」ノズル搭載

「ノズルが詰まりにくい」新型の「V5ノズル」を標準装備。これまでエラー原因として多かった「ノズル詰まり」を大幅に改善しました。またノズル温度はこれまでの 250°C から「300°C」に上昇。これまでのエンブラはもちろん、高温域のフィラメントまで使用が可能になりました。



## 「BuildTAK」が初期備品に標準装備

これまでオプションだった定着シートの「BuildTAK」が初期備品に加わり造形が安定して行えるようになりました。



## フィラメント切れセンサー搭載

印刷時によくある「材料切れ」による失敗を軽減。安定した印刷が可能になりました。



## 初期備品に「トップカバー」が追加されました

これまでオプションだった保温用「トップカバー」も初期備品に加わりオプションなしで ABS、PC の造形が行えるようになりました。



## 新型ホットベッド

これまでのホットベッドヒーターをビルドプレート全面に広げ、ホットベッドの温度ムラを極力抑えました。

